



Taiwan Polyimide

We know Polyimide

法說會報告資料

Kevin Chen/Paul S. C. Wu

Nov. 15, 2021

CONFIDENTIAL

免責聲明

本簡報係由達邁科技股份有限公司(以下簡稱本公司)提供，本簡報可能包含前瞻性陳述，當中涉及風險與不明朗因素包括陳述本身的不確定性、風險、假設或其他因素如：經營上的改變、競爭環境、經濟情勢、法規變化、科技發展與超出本公司管控等因素，皆可能導致本公司實際營運結果與上開前瞻性陳述有很大的差異。本公司不承擔因情勢變更而即時更新或修正相關內容之義務。

本簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任何有價證券或金融商品的邀約，邀約之引誘或建議。本公司已盡合理之注意，使本簡報於公開時無任何不真實或誤導。本公司及其各關係企業代表人或董事，均不對此使用或因他人引用本份簡報資料、或其它因簡報資料導致的任何損害負擔任何責任。

公司簡介

2021年Q1-Q3營運暨應用市場概況

公司發展策略 & 布局未來

問題與交流

公司簡介

Company Profile 簡介

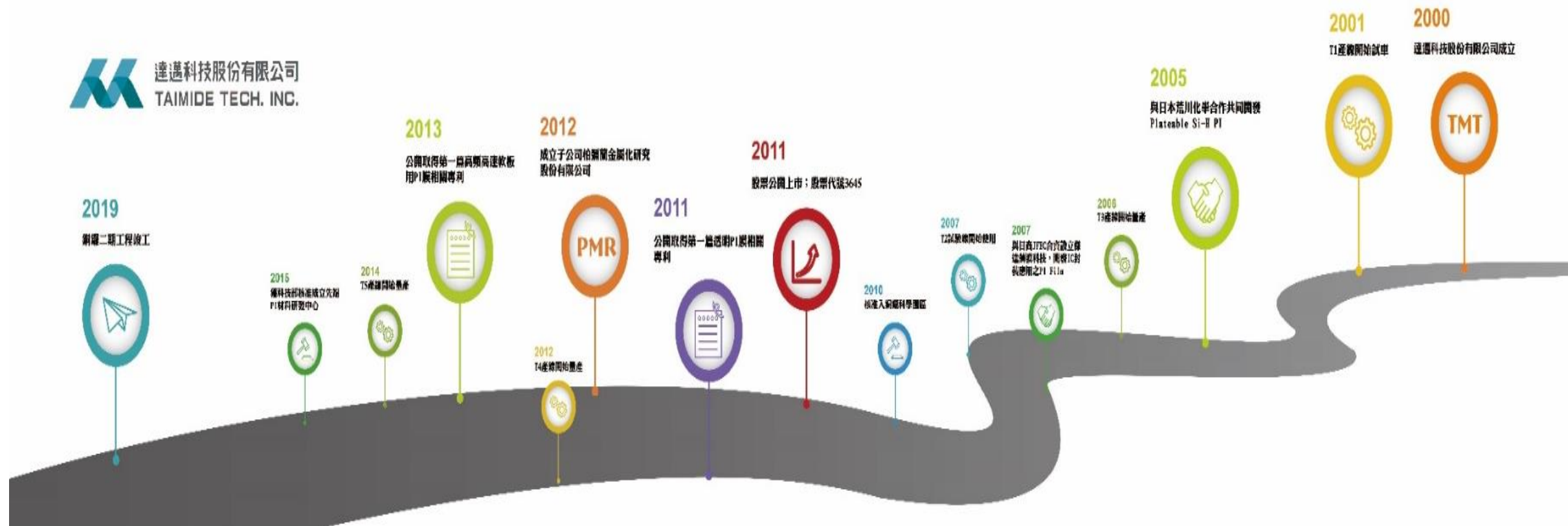


Polyimide Film
Manufacturer

- Established: June, 2000
- Company capital: ~47M USD
- Plant sites: Hsinpu & Tongluo
- Employees: ~400
- IPO in TSE: October, 2011

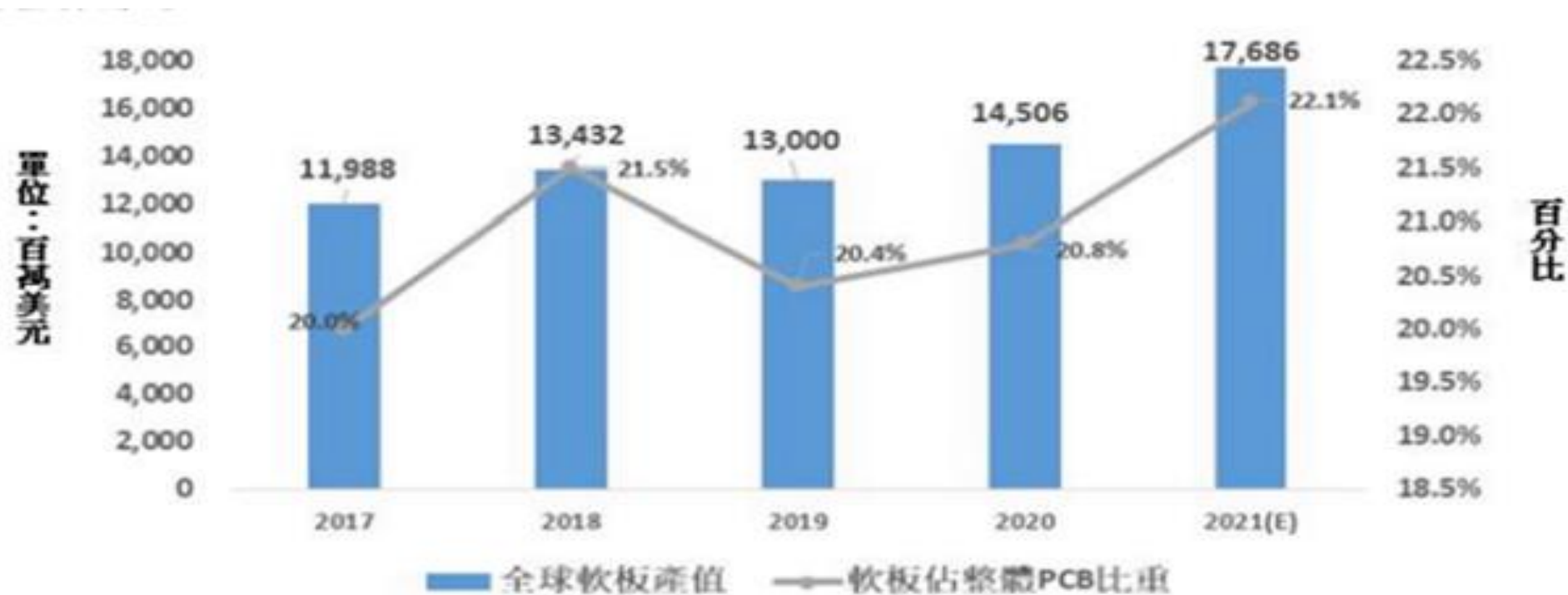


Milestones 大事紀



2021年Q1-Q3營運 暨應用市場概況

軟板產值變化



註：包含後段元件組裝產值

資料來源：TPCA：工研院產科國際所 (2021/08)

軟板應用範圍擴大

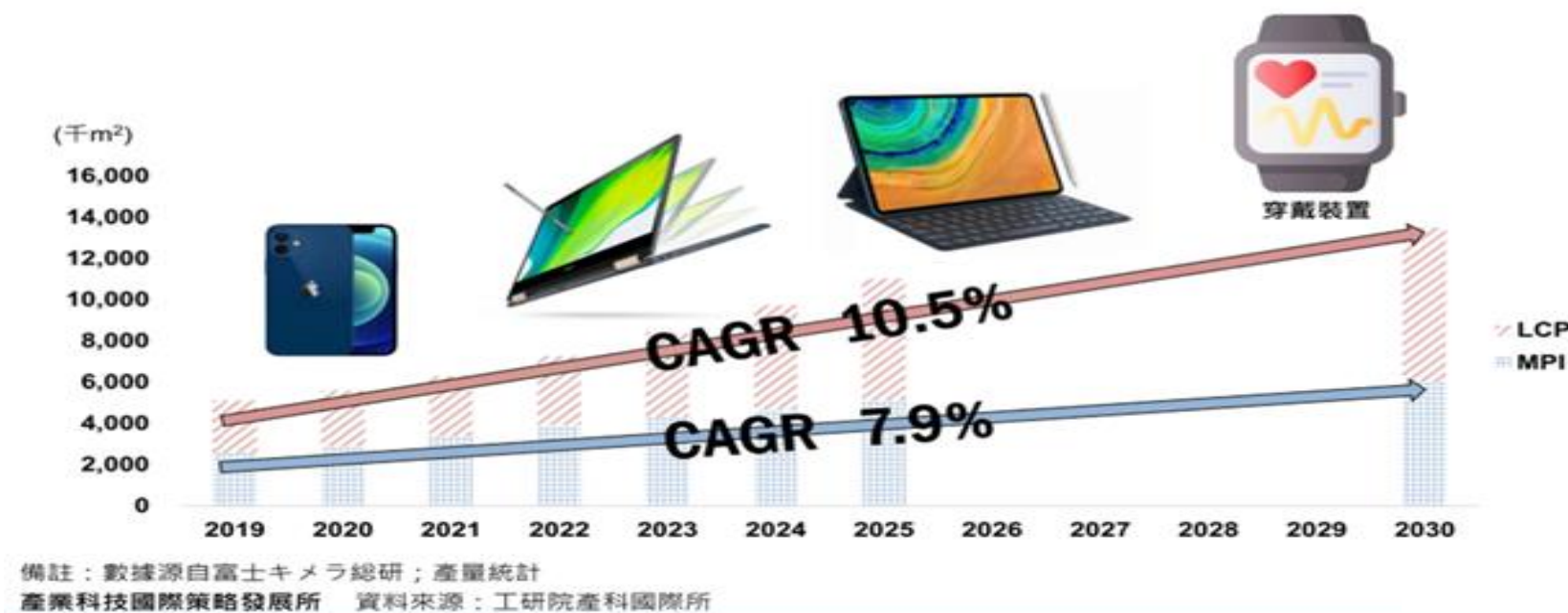


資料來源：TPCA：工研院產科國際所(2021/08)

5G、高頻高速軟板材料市場

終端支援5G、高頻高速軟板材料市場將持續成長

- 未來智慧型手機、平板、筆電、穿戴裝置等終端產品都將5G連網。
高頻高速軟板數量增加，高頻高速軟板材料需求隨之成長。



電動車用電路板產值



資料來源：工研院產科國際所

2021年Q1-Q3營運情形

綜合損益表



單位：新台幣佰萬元

綜合損益表項目	3Q21	2Q21	YT3Q21	YT3Q20	季變化	年變化
營業收入淨額	649.55	586.54	1,833.71	1,414.45	10.7%	29.6%
營業毛利率	30.1%	29.5%	32.0%	37.8%	0.6ppts	-5.8ppts
營業費用	92.14	88.83	273.73	236.27	3.7%	15.9%
營業利益	103.69	83.99	312.36	297.82	23.5%	4.9%
營業外收入及支出	4.67	(9.49)	(12.71)	(21.47)	-149.2%	-40.8%
稅前淨利	108.36	74.51	299.65	276.34	45.4%	8.4%
所得稅費用	27.67	0.70	56.67	12.75	3869.9%	344.4%
合併本期淨利	80.69	73.80	242.98	263.59	9.3%	-7.8%
純益率	12.4%	12.6%	13.3%	18.6%	-0.2ppts	-5.3ppts
每股盈餘(新台幣元)	0.63	0.58	1.91	2.09	8.6%	-8.6%

CONFIDENTIAL *2021年第三季加權平均流通在外股數為131佰萬股

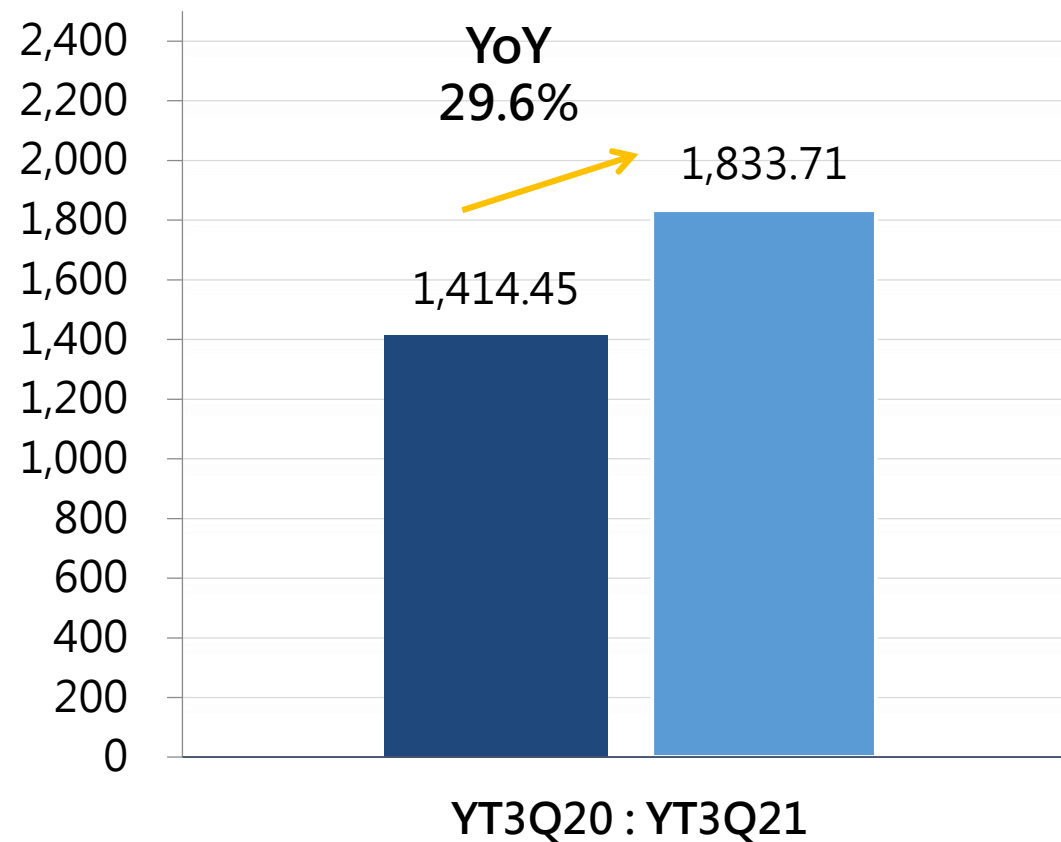
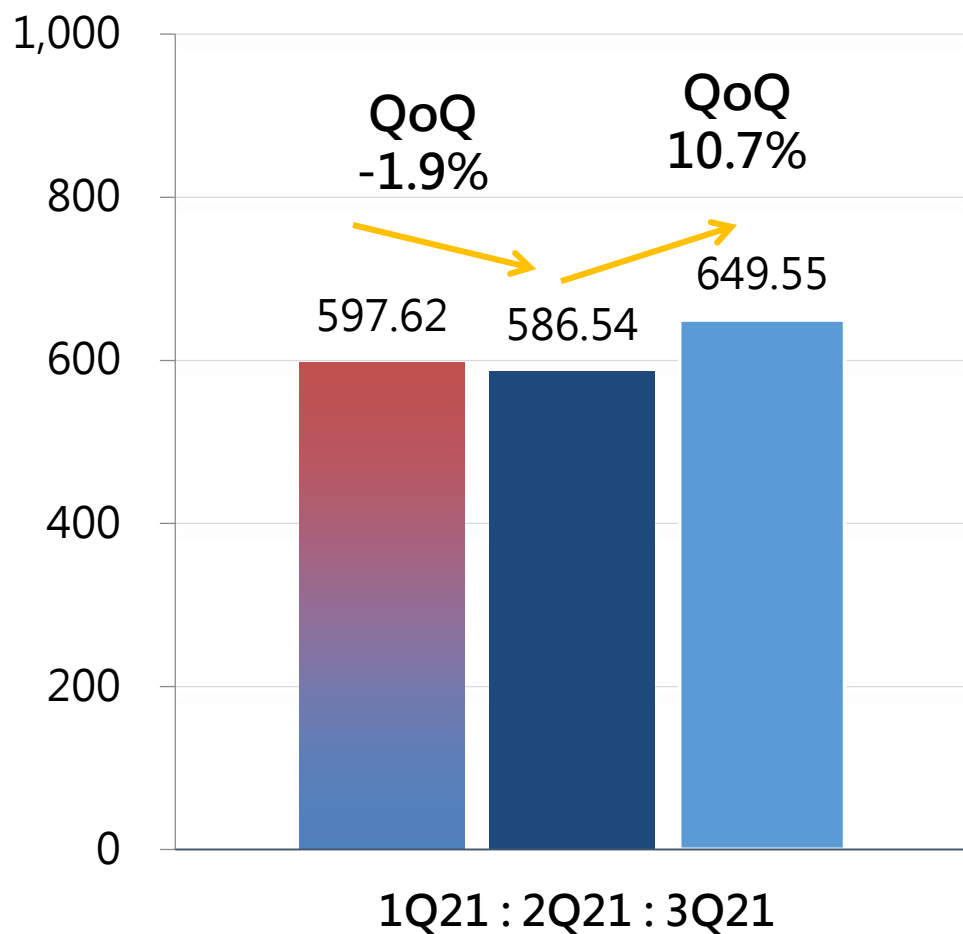
毛利

B/S

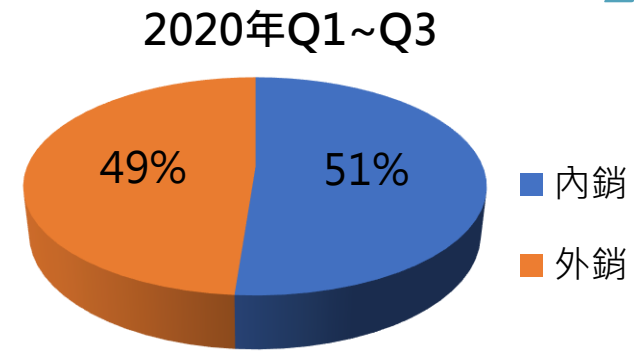
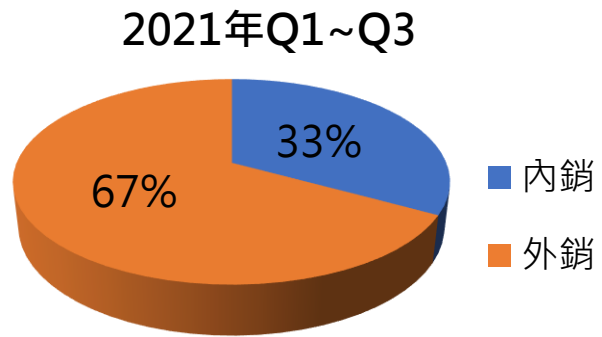
合併營業收入



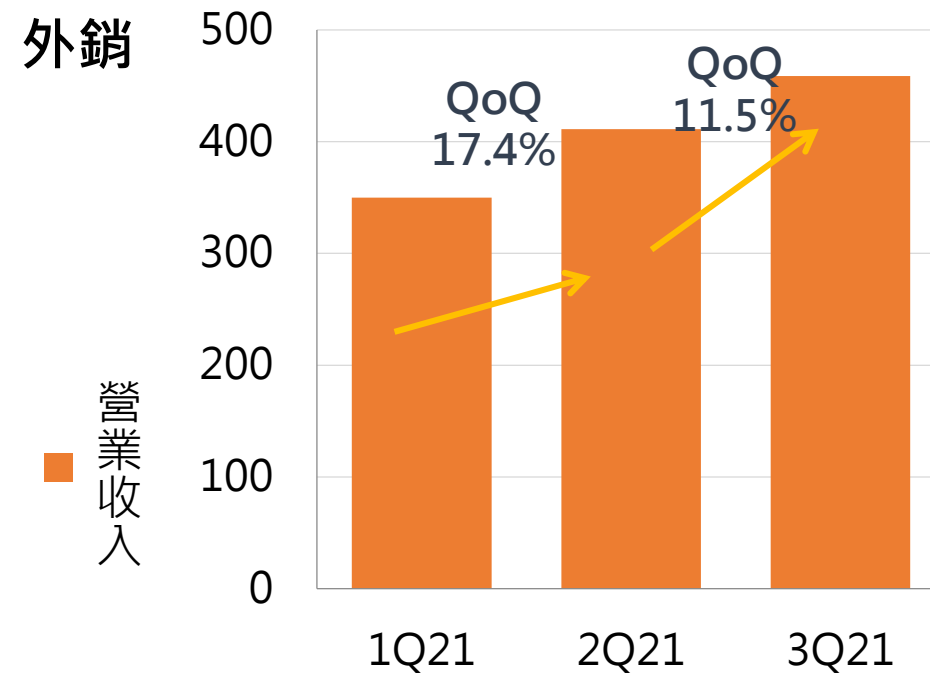
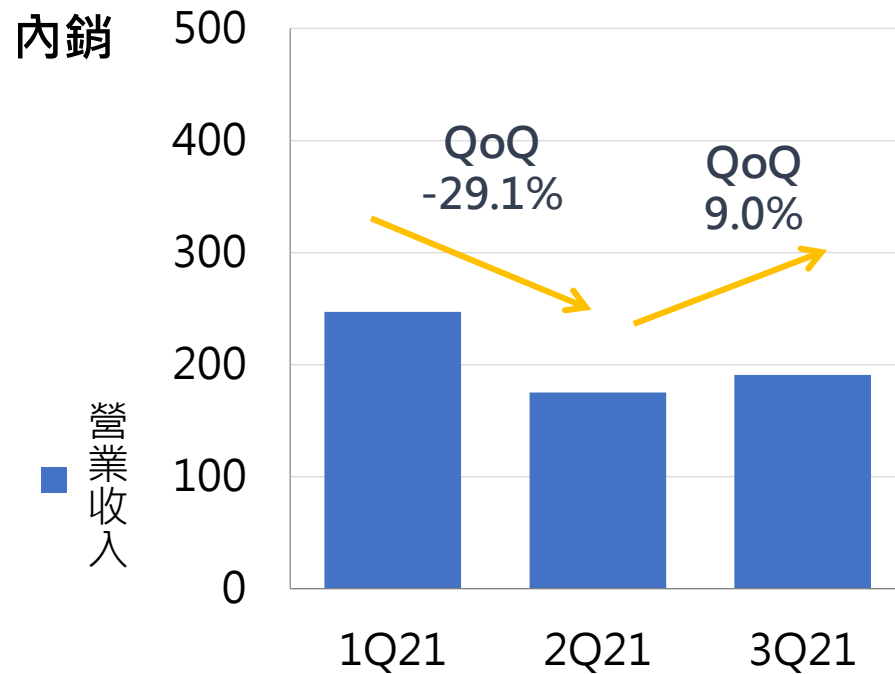
單位：新台幣佰萬元



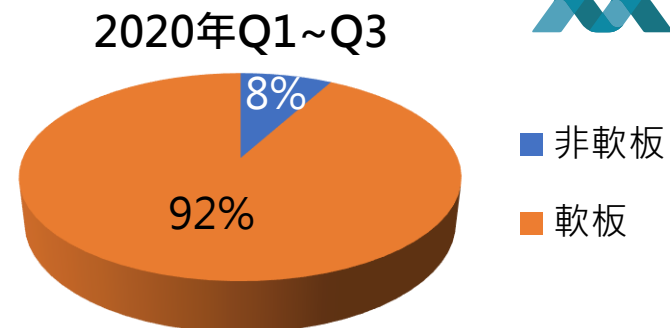
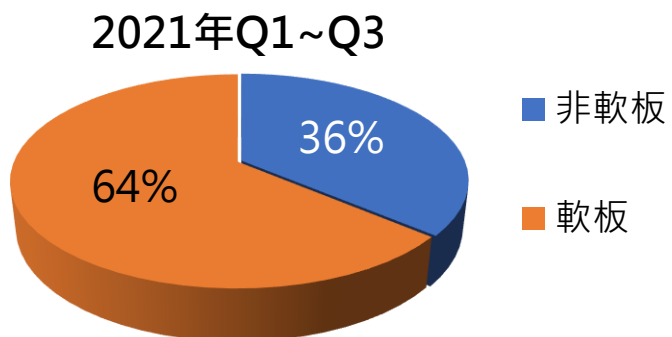
銷售市場



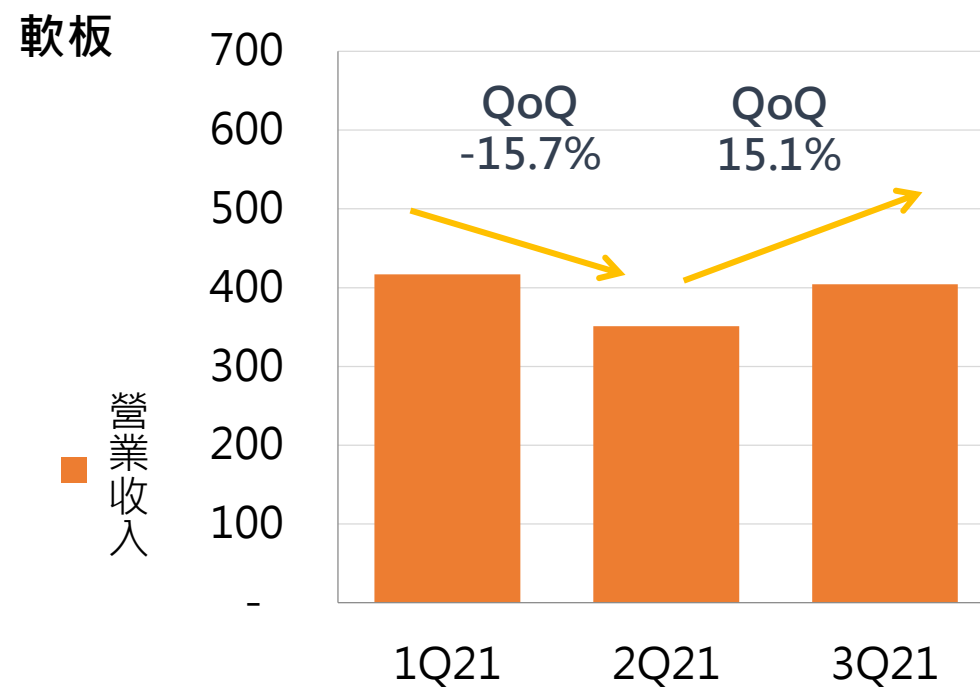
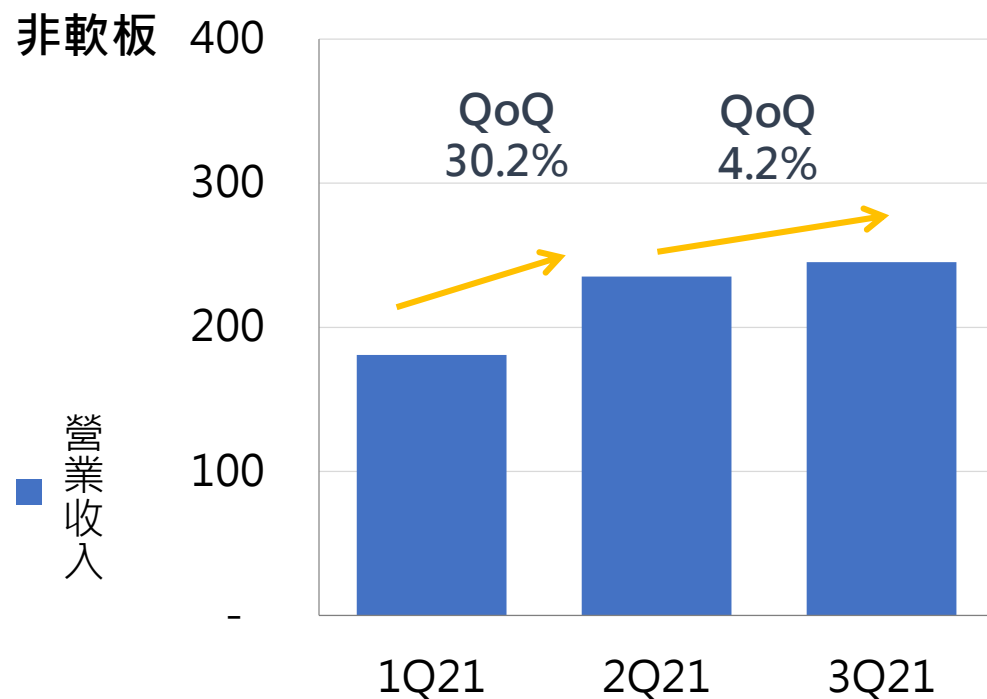
單位：新台幣佰萬元



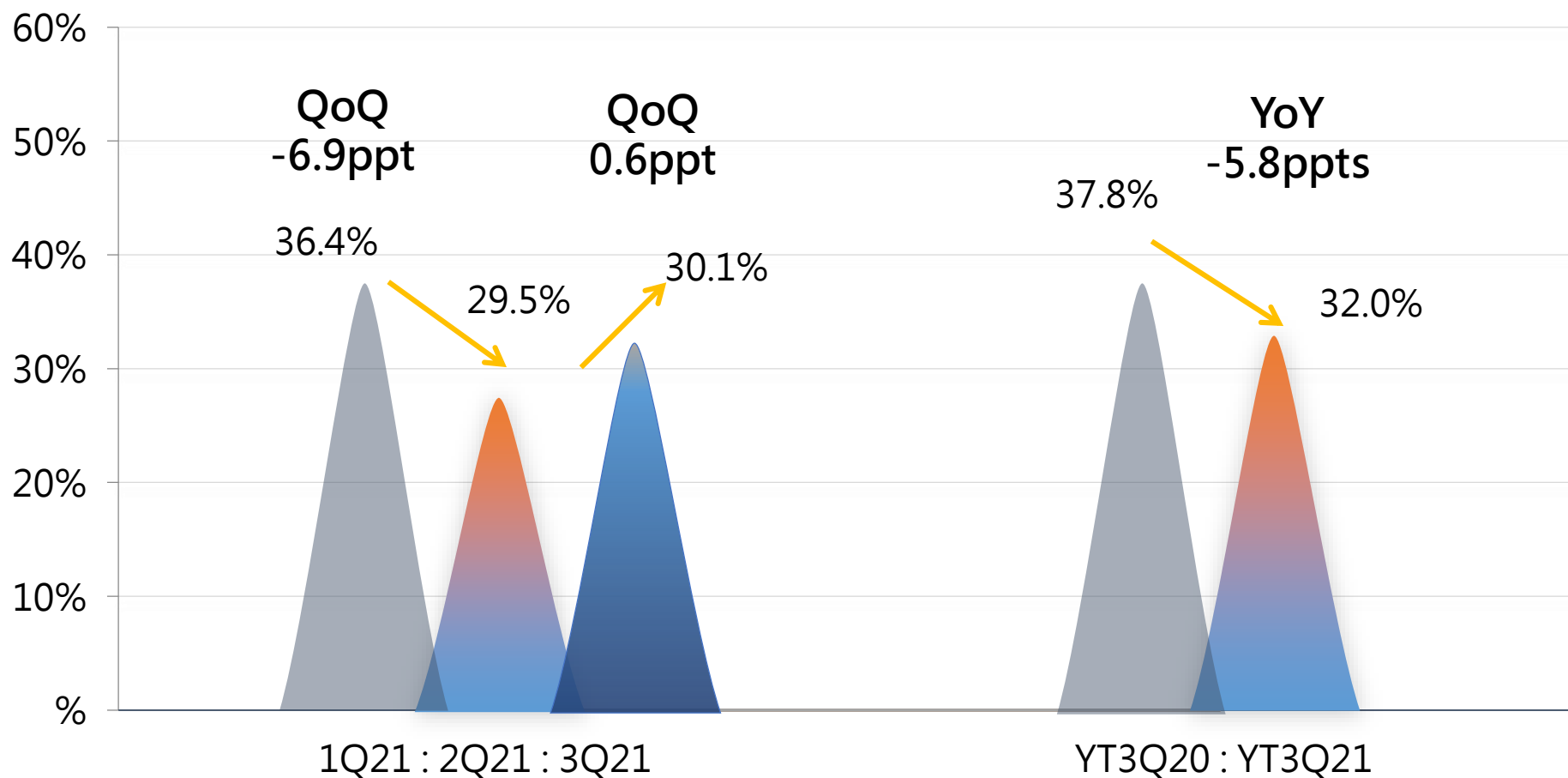
應用市場



單位：新台幣佰萬元

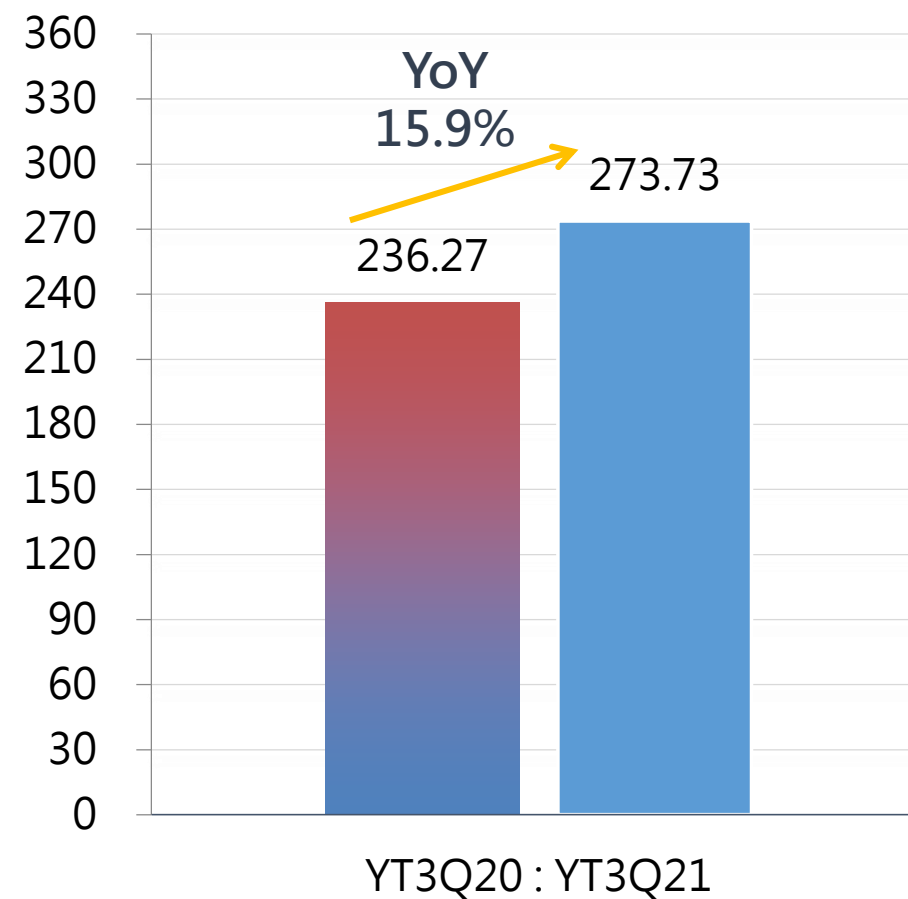
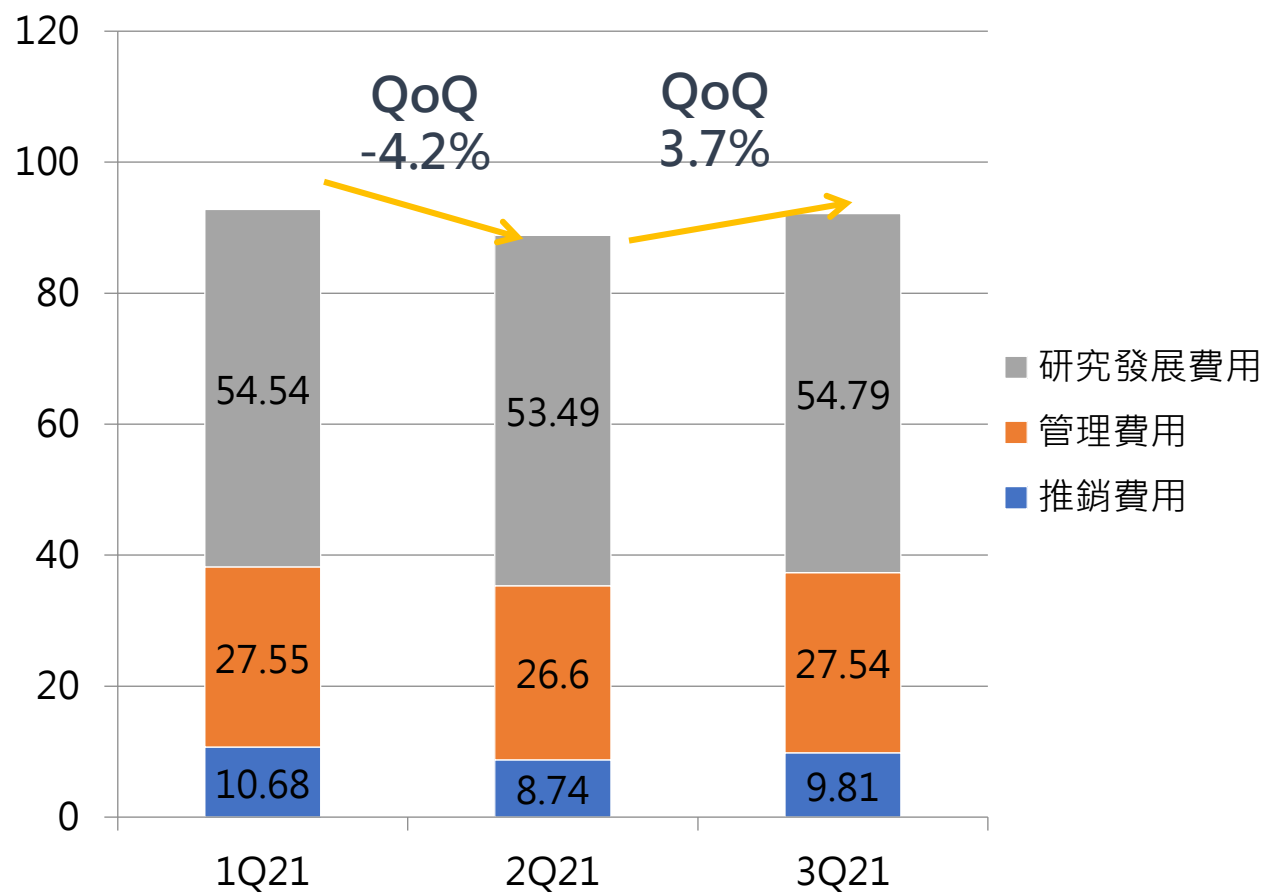


合併營業毛利率



合併營業費用

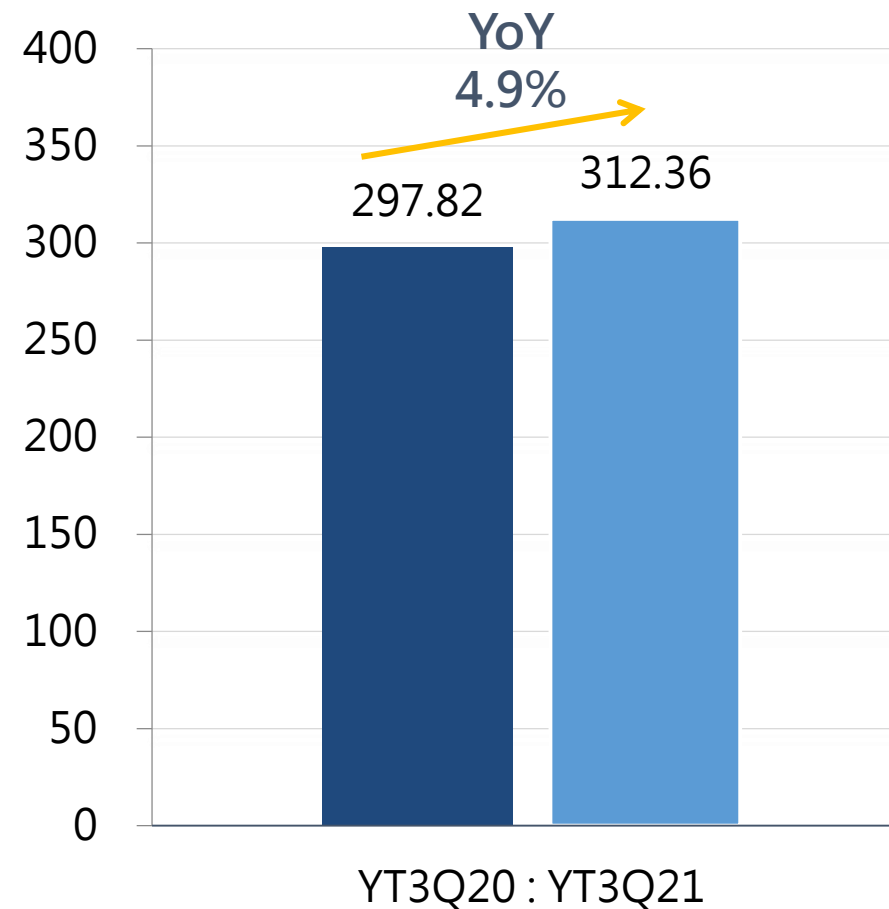
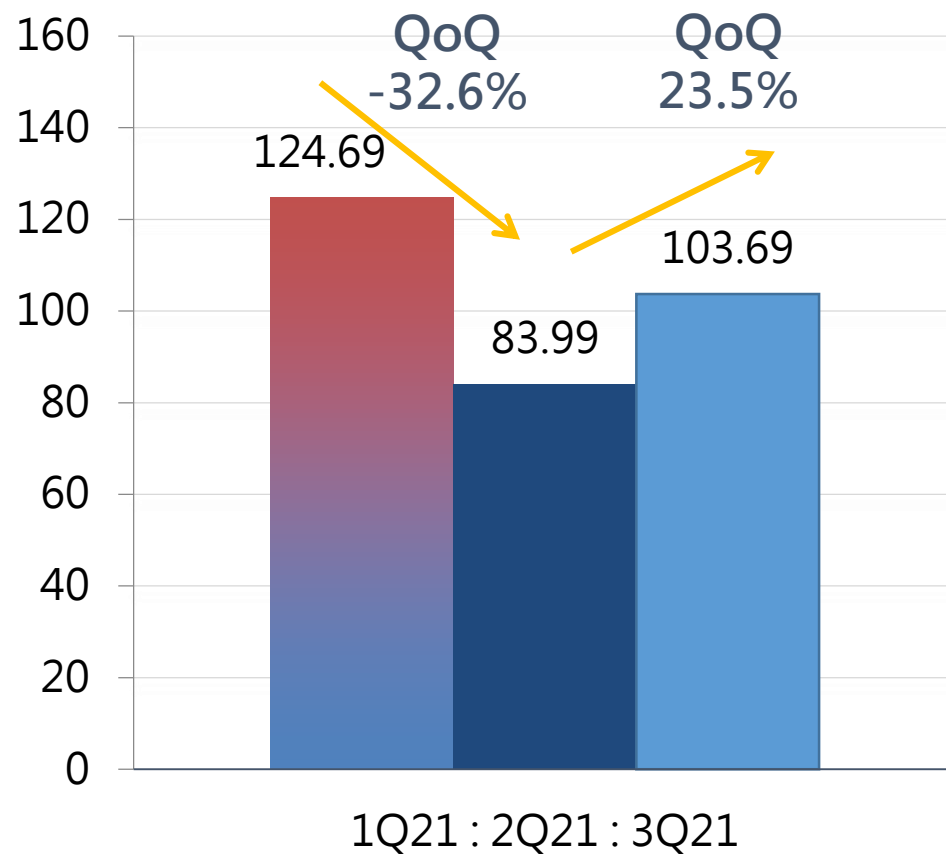
單位：新台幣佰萬元



合併營業利益



單位：新台幣佰萬元



資產負債表及重要財務指標



資產負債表項目	3Q21		2Q21		1Q21		3Q20	
單位：新台幣佰萬元	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
現金及有價金融商品投資	407.32	7.9%	502.62	9.6%	379.39	7.4%	337.09	6.7%
應收帳款	573.17	11.1%	572.71	10.9%	598.42	11.7%	556.93	11.1%
存貨	425.00	8.2%	415.68	7.9%	342.55	6.7%	303.76	6.0%
不動產、廠房及設備	3,398.77	65.7%	3,392.29	64.5%	3,414.30	66.9%	3,458.86	68.8%
資產總計	5,169.53	100.0%	5,261.72	100.0%	5,104.15	100.0%	5,025.62	100.0%
流動負債	937.21	18.1%	900.61	17.1%	931.24	18.2%	874.60	17.4%
長期計息負債	1,190.29	23.0%	1,204.11	22.9%	1,087.05	21.3%	1,235.12	24.6%
負債總計	2,327.29	45.0%	2,309.61	43.9%	2,228.33	43.7%	2,328.78	46.3%
權益總計	2,842.24	55.0%	2,952.11	56.1%	2,875.82	56.3%	2,696.84	53.7%
重要財務指標								
平均銷貨日數	82.40		85.25		80.24		94.66	
流動比率(倍)	1.61		1.77		1.52		1.47	
資產生產力(倍)	0.72		0.70		0.70		0.56	

*2021年第三季加權平均流通在外股數為131佰萬股

**資產生產力=年化營業收入淨額/平均不動產、廠房及設備淨額

公司發展策略 & 布局未來

雙十展翼、再創新局 (第二講)

A. 兩支硬翅膀的 **布局**

a. 第一支翅膀: Fluomide® for 5G

b. 第二支翅膀: OPI® for Foldable AMOLED

B. VCP 的發展 **策略**

達邁新格局: Not only PI film Manufacturer , but also a Value Chain Provider (**VCP**)

從近期最夯的話題談起

虛實整合的元宇宙(Mataverse)



微軟執行長 納德拉：

元宇宙的概念是，在真實世界中嵌入運算、
在運算中嵌入真實世界。



資料來源:商周第1773期





■佐伯格與奧運金牌以虛擬實境比擊劍，但元宇宙能否解決一般人的痛點？恐怕才是它能否普及的關鍵。



■不認識雅虎台灣虛擬偶像家族中的虎妮（左）、杏仁咪嚕（右），你會被小學生嘲笑落伍喔！

資料來源:商周第1773期

臉書、微軟爭元宇宙王座 台灣內容、硬體機會大



平台、遊戲與應用

- 國際大咖：臉書、微軟、PTC、Epic、Roblox、Niantic、STEAM
- 台灣公司：宏達電、Xrspace、雅虎台灣、遊戲橘子、南瓜、瓊檬、科碼新、狂點、必揚、宇萌、OURSONG



AI與底層技術

- 國際大咖：輝達、Adobe、Autodesk、Unity
- 台灣公司：訊連、光禾感知、兇獠、iStaging、Blocto



整理：蔡韻萱

使用者終端



- 國際大咖：臉書、蘋果、索尼、微軟
- 台灣公司：宏達電、Xrspace、佐鍾



零組件與組裝



- 國際大咖：輝達、英特爾、AMD
- 台灣公司：聯發科、奇景、台積電、聯電、鴻海、和碩、廣達



資料來源：商周第1773期



蘋果執行長 庫克：

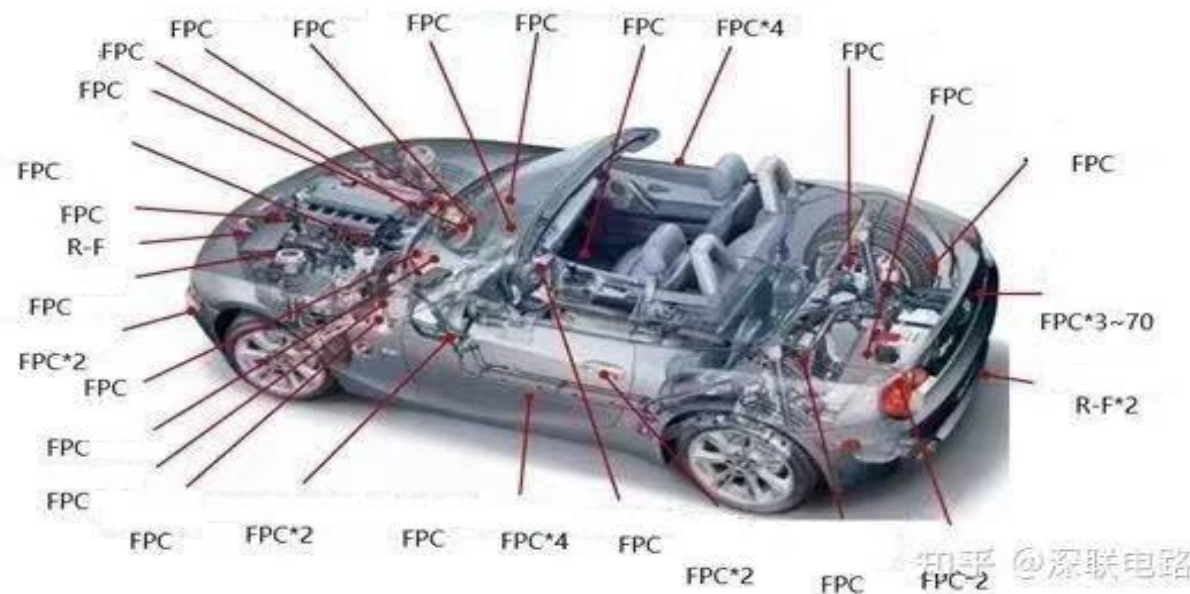
“我寧願離流行語遠一點、稱它為AR，**我對此非常興奮、樂觀，**
預料這將能為人們省下時間，從事更多有意義的活動。”

資料來源:以上取材自商業週刊 1773 期，p80~84

近期產業最夯的話題之二

汽車變革的進行式：輔助駕駛、自動駕駛、油電車、電動車、燃料電池車……

FPC+RF: 42~109條



資料來源: Google

序號⑤~⑧：執行「決策與控制」程序

- ⑤ GPS接收器
辨識車輛於地圖中位置
- ⑥ 電腦資料運算平台
透過感應器蒐集資訊
決定車輛行進動線
- ⑦ 定位感測器
監控車輛是否偏移
GPS地圖中位置
- ⑧ 電子線控
(X-by-wire)

序號①~④：執行「感測」程序

- ① 光達
360度旋轉，掃描周遭
200公尺環境並繪成3D
- ② 慣性動作感測器
因應GPS訊號微弱時，
提供航位推算功能
- ③ 攝影機
負責判讀交通號誌，
並偵測移動障礙物
- ④ 毫米波雷達
判斷車輛遠距離
物體位置與距離

資料來源:蘇文彥 5G世代軟板高頻材料及微細線路製程簡介

FPC for Automotive



Features

- Total Cost Down
- Integration of PCB and Wiring
- Light Weight
- High Heat Resistance
- Space Saving
- 3D Wiring
- Improve Reliability
- Components Assy



LCD



Daytime Running Light



Gearbox Control Unit



Li-B Management System



Window Connector

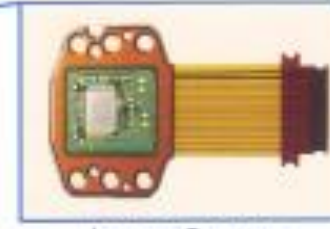


Image Sensor



Column Switch



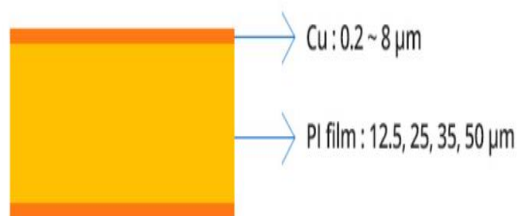
Camera Heater



Sensor、Process、Actuator的關係



柏彌蘭金屬化研究(PMR)公司簡介



PMR發展歷程

- 成立於：2012.6
- 資本額：2.2億元
- 公司位置：桃園平鎮
- 核心技術：RTR PI濕式金屬化
- 主要產品：軟性超薄銅箔基板、微細線路軟板
- 專利件數：申請45篇，已核准29篇

2016 開發RTR PI pre-drilled技術與設立PI金屬化量產線

2018 開發FOG成為三合一方案

2019 王牌公司(客戶代號)成為首家採用PMR三合一方案
開發AR眼鏡

2020 國際醫療大廠評估採用，建立FOG製程產線



預鑽孔超薄銅基板+MSAP



PI 薄膜 (*POMIRAN®*)



RTR 雷射預鑽孔
(*Laser pre-drill*)



RTR 化學鍍鎳
(*Metal-seed plating*)



RTR 電解電鍍銅
(*Conductor plating*)



RTS FPC製作
(*RTS MSAP FPC
Processing*)



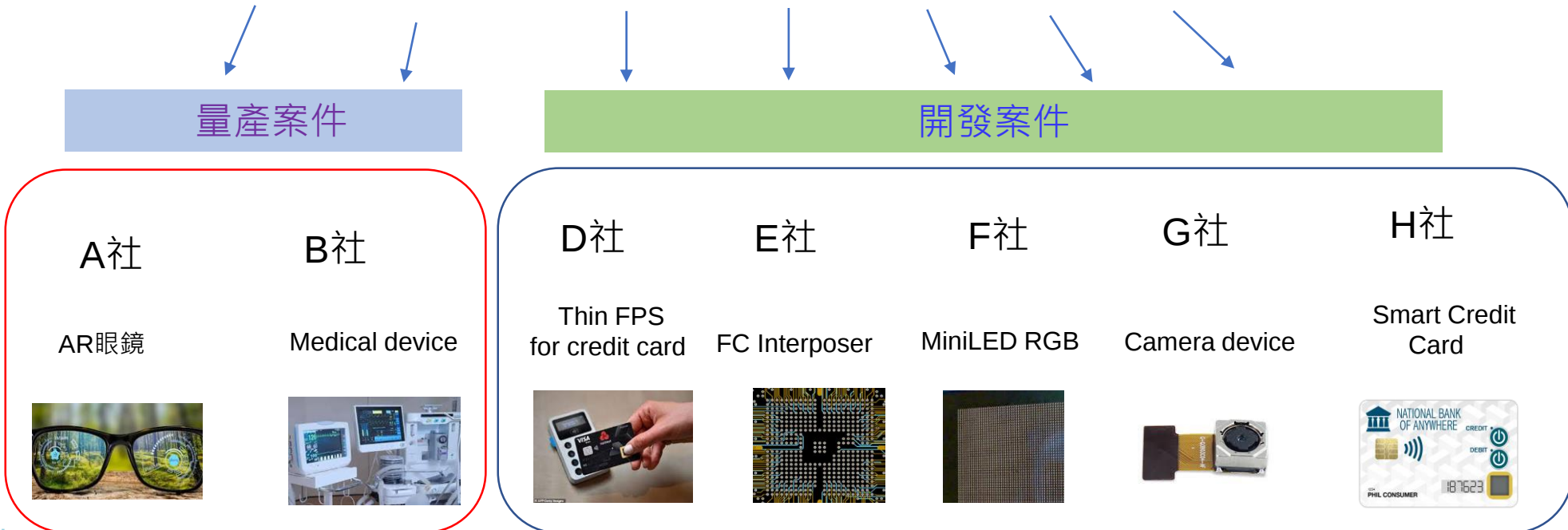
協力廠商

PMR三合一方案

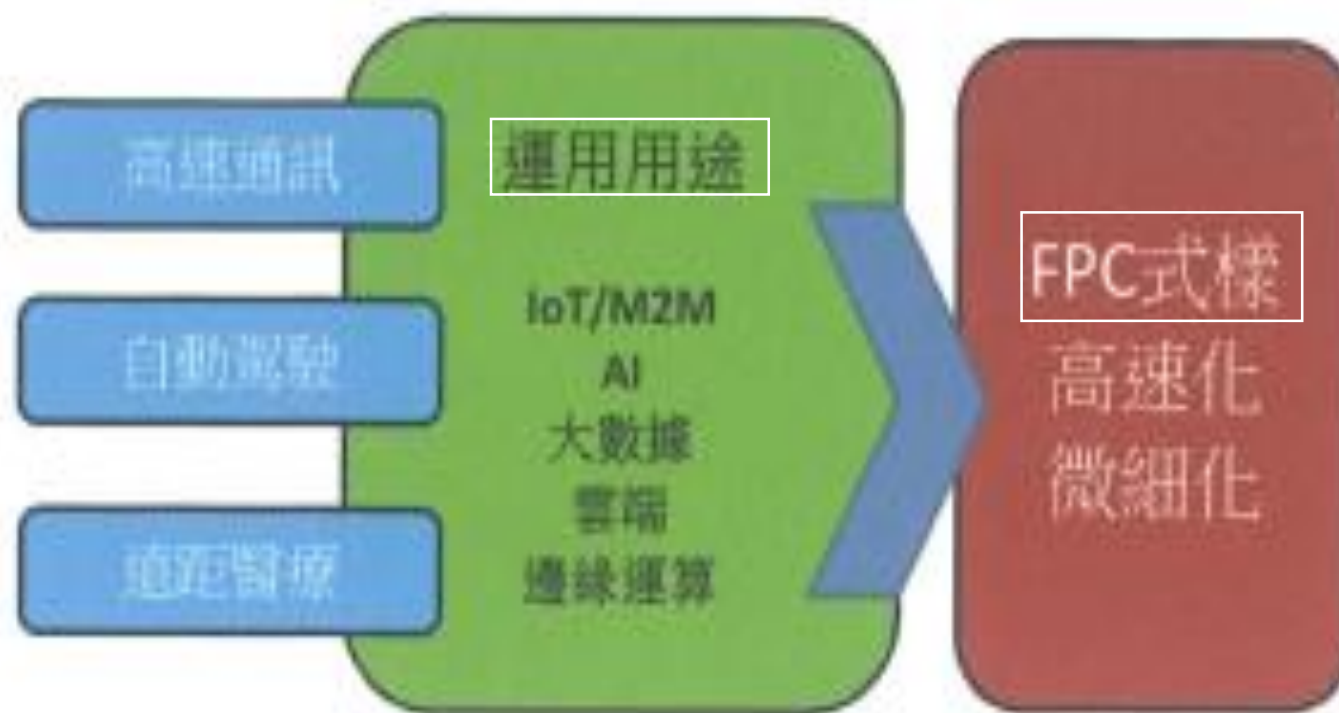
1. PI Pre-drill & Metallize (預鑽孔金屬化材料) -- TMT/ PMR

2. Fine line Circuit FPC (MSAP線路加工) -- 協力廠商

3. FPC on Carrier with PI Debonded Film (FOG製程材料) – TMT/PMR



未來FPC的發展趨勢



資料來源:蘇文彥 5G世代軟板高頻材料及微細線路製程簡介

達邁現在、未來的角色

A. 兩支硬翅膀的 **布局**

a. 第一支翅膀: Fluomide® for 5G

b. 第二支翅膀: OPI® for Foldable AMOLED

B. VCP 的發展 **策略**

達邁新格局: Not only PI film Manufacturer , but also a Value Chain Provider (**VCP**)

問題與交流

THE END